

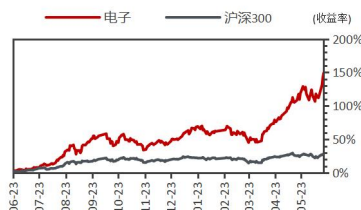
SK Hynix 送样 12 层 HBM4E，AI 高端存储迭代提速

行业及产业

电子

强于大市

一年内行业指数与沪深 300 指数对比走势：



资料来源：聚源数据，爱建证券研究所

相关研究

《电子行业周报：NVIDIA 携手 SK Hynix 共建 AI 内存与半导体智造新生态》2026-06-15

《电子行业专题报告：Vera Rubin 量产提速，RTX Spark 打开终端 AI 新空间》2026-06-08

《电子行业周报：端侧 AI PC 产业化落地，云端算力需求持续爆发》2026-06-08

《电子行业周报：长鑫科技 IPO 迎来关键节点，Intel 加码玻璃基板与硅光子》2026-06-01

《电子行业专题报告：华为发布 τ 定律，助力后摩尔时代半导体产业发展》2026-05-28

证券分析师

许亮
S0820525010002
0755-83562506
xuliang@ajzq.com

联系人

朱俊宇
S0820125040021
021-32229888-25520
zhujunyu@ajzq.com

——电子行业周报（20260615-20260621）

投资要点：

- **电子板块行情复盘：**本周 SW 电子指数上涨 17.49%，跑赢沪深 300 指数（+3.44%），在 SW 一级行业指数中排名 1/31。受益 AI 算力高景气需求，叠加半导体国产替代政策催化，行情弹性全面释放。各细分板块中，被动元件（+25.78%）、印制电路板（+20.28%）、数字芯片设计（+19.80%）涨幅居前，仅品牌消费电子小幅收跌（-0.05%）。
- **个股方面：**本周电子板块内涨幅前五个股分别为国瓷材料（+58.94%）、昀冢科技（+57.35%）、普冉股份（+51.05%）、旭光电子（+46.43%）、科翔股份（+45.05%）；跌幅前五分别为朝阳科技（-22.23%）、清越科技（-15.38%）、经纬辉开（-6.69%）、蓝箭电子（-6.06%）、菲沃泰（-4.16%）。
- **2026 年 6 月 18 日，SK Hynix 宣布向核心客户送出 12 层 HBM4E 样品，该产品为面向 AI 场景的新一代高性能 DRAM。**对比前代 HBM4，HBM4E 实现性能、能效双重升级，最高引脚速率达 16Gbps，能效提升 20% 以上。产品依托全新接口与架构设计降低传输延迟，高带宽工况下运行稳定，既能强化 AI 训练与推理的数据处理能力，也能有效提升新一代 AI 数据中心、大型计算系统整体运算效率。SK Hynix 具备 HBM3、HBM3E、HBM4 成熟量产供货基础，后续将持续协同客户推进 HBM4E 迭代优化，缓解 AI 算力硬件性能瓶颈，支撑全球新一代算力基础设施搭建。我们认为，本次 HBM4E 样品送样落地，将进一步巩固公司高端 HBM 供给优势，持续拉动 AI 存储产业链景气上行。
- **2026 年 6 月 16 日，TSMC 与 Amkor 签署十年合作协议，加码美国亚利桑那先进封装产能，完善本土半导体供应链。**双方搭建长期采购框架，TSMC 向 Amkor 采购先进封装、芯片测试服务配套凤凰城晶圆厂，厂区就近布局可缩短芯片交付周期，打造一体化本地供应链。Amkor 在皮奥里亚投 70 亿美元建设两期封装园区，洁净面积 75 万平方英尺，创造 3000 个岗位；一期 2027 年中完工、2028 年初投产，量产 InFO、CoWoS 工艺，服务 AI 与高性能芯片。Amkor 同步扩建韩国光州工厂承接台积电全球订单，TSMC 亦计划 2029 年前在亚利桑那自建 CoWoS、3D IC 产线，与安靠产能互补。我们认为，本次长约落地补齐美国本土高端封装产能，加速海外算力芯片本地化生产，先进封装行业需求有望持续扩张。
- **投资建议：建议关注国产存储产业链相关投资机会。**SK Hynix 推出新一代 12 层 HBM4E 并向客户送样，产品性能、能效相较 HBM4 大幅优化，叠加公司成熟 HBM 量产交付能力，将持续推高 HBM 及上下游产业链景气度，AI 内存增量市场空间广阔。
- **风险提示：1) 海外存储大厂技术迭代、产能释放超预期：**SK Hynix HBM4E 已完成客户送样，若后续快速实现大规模量产、大幅放开高端 HBM 产能供给，会加剧全球 HBM 市场供给竞争，压缩国内存储厂商 HBM 产品的价格与盈利空间，延缓国产存储份额提升节奏。2) **国产存储技术研发与量产进度不及预期：**当前 SK Hynix 海外厂商已完成新一代 HBM 样品验证并推进迭代，若国内厂商在 12 层及以上堆叠 HBM、高速接口等核心技术研发落地、良率爬坡进度滞后，将持续拉大与海外龙头产品代差，难以充分承接 AI 内存增量市场红利。

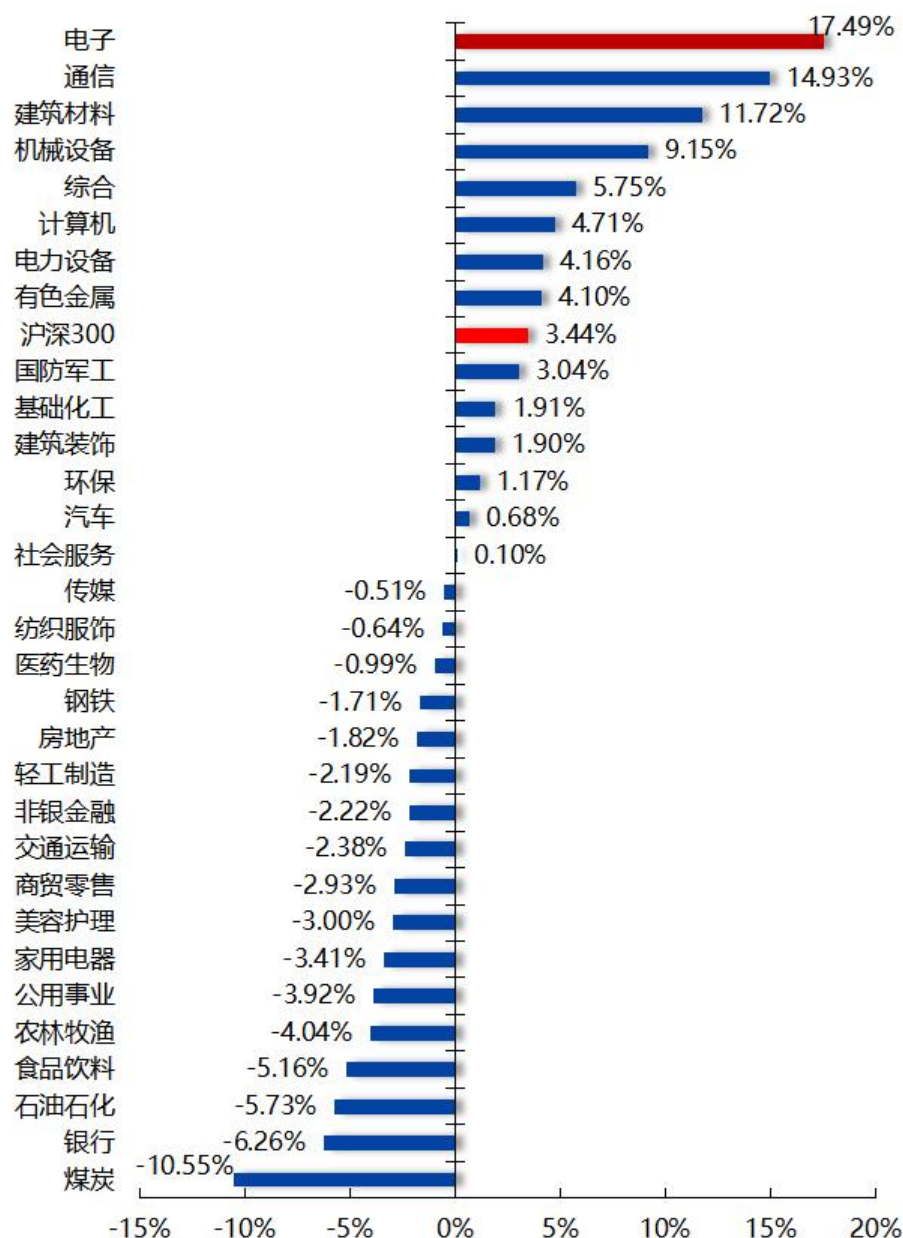
1. 本周市场回顾

1.1 SW 一级行业涨跌幅一览

本周 SW 电子指数上涨 17.49%，跑赢沪深 300 指数（+3.44%），在 SW 一级行业指数中排名 1/31。受益 AI 算力高景气需求，叠加半导体国产替代政策催化，行情弹性全面释放。

SW 一级行业涨跌幅排名前五的板块分别为：电子（+17.49%）、通信（+14.93%）、建筑材料（+11.72%）、机械设备（+9.15%）、综合（+5.75%）。排名后五的板块分别为：煤炭（-10.55%）、银行（-6.26%）、石油石化（-5.73%）、食品饮料（-5.16%）、农林牧渔（-4.04%）。

图表 1：本周 SW 一级行业涨跌幅一览

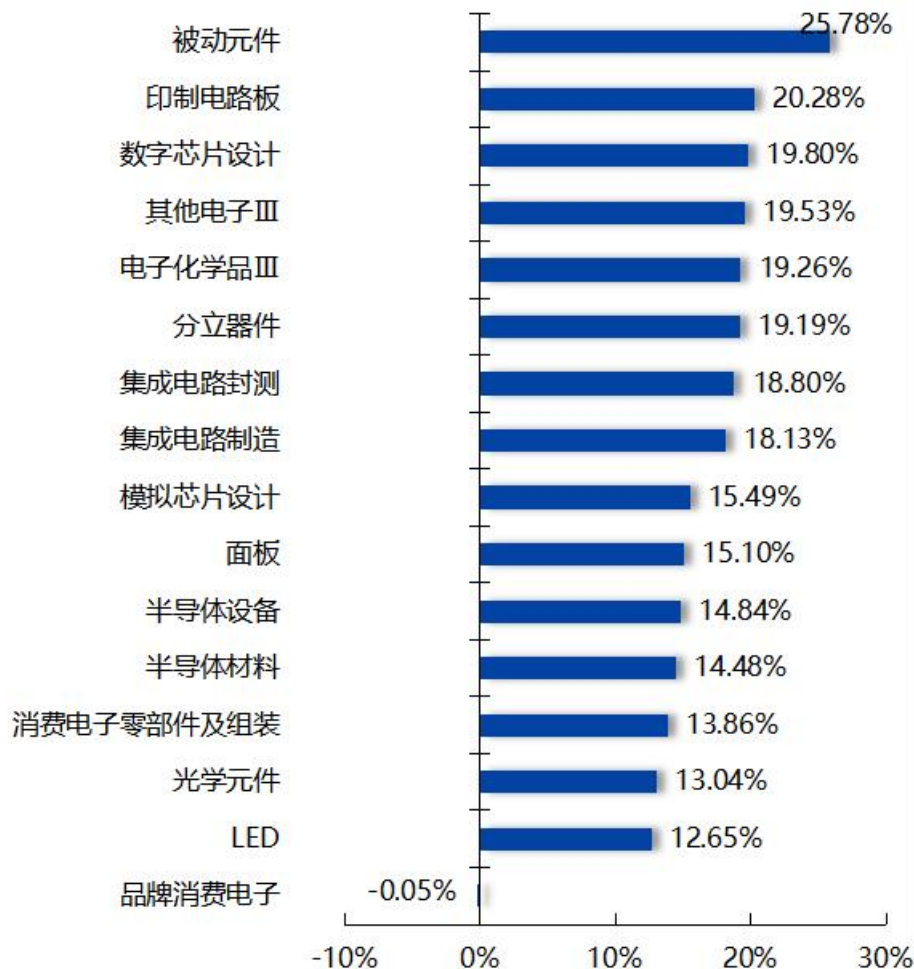


资料来源：iFinD，爱建证券研究所

1.2 SW 电子三级行业市场表现

本周 SW 电子三级行业分化显著，涨跌幅排名前三的细分赛道分别为被动元件（+25.78%）、印制电路板（+20.28%）、数字芯片设计（+19.80%）；涨跌幅排名后三的细分赛道分别为品牌消费电子（-0.05%）、LED（+12.65%）、光学元件（+13.04%）。

图表 2：本周 SW 电子三级行业涨跌幅一览

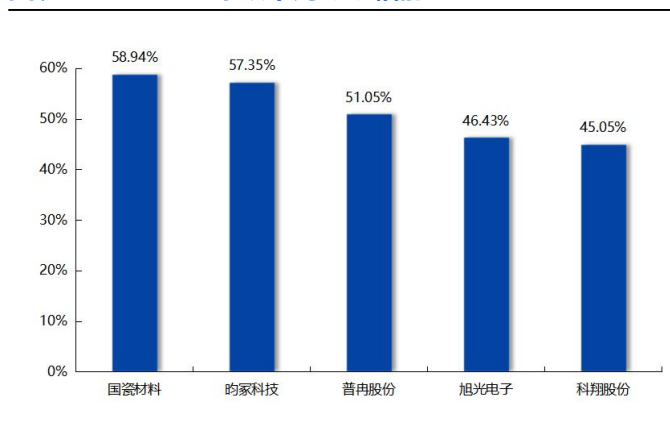


资料来源：iFinD，爱建证券研究所

1.3 SW 电子行业个股情况

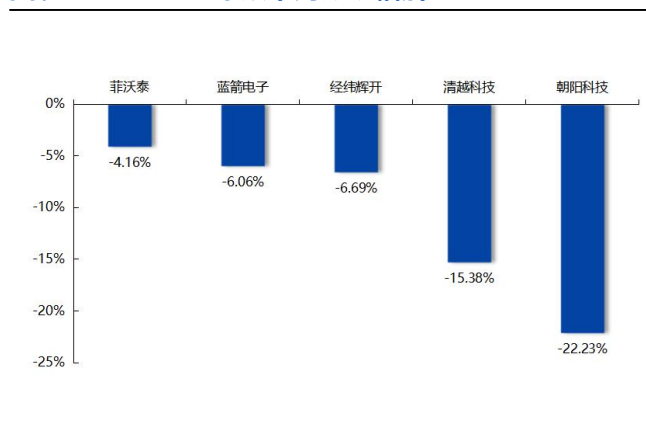
本周 SW 电子板块内个股分化加剧，涨幅前五的个股分别为国瓷材料（+58.94%）、昀冢科技（+57.35%）、普冉股份（+51.05%）、旭光电子（+46.43%）、科翔股份（+45.05%）；跌幅前五的个股分别为朝阳科技（-22.23%）、清越科技（-15.38%）、经纬辉开（-6.69%）、蓝箭电子（-6.06%）、菲沃泰（-4.16%）。

图表 3：SW 电子个股本周涨跌幅前五



资料来源：iFinD，爱建证券研究所

图表 4：SW 电子个股本周涨跌幅后五

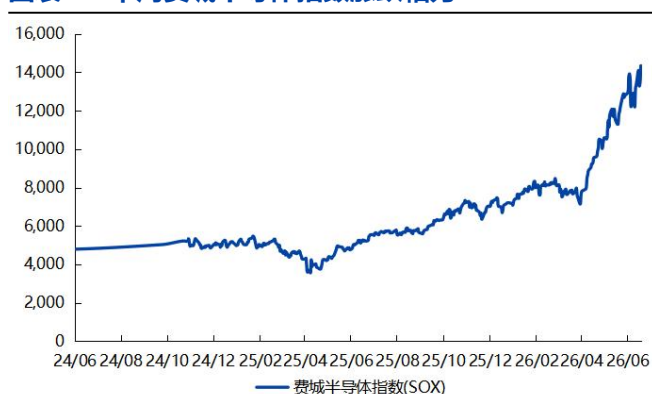


资料来源：iFinD，爱建证券研究所

1.4 SW 科技行业其他市场表现

费城半导体指数 (SOX) 本周涨跌幅为+7.26%，恒生科技指数本周涨跌幅为-2.14%。

图表 5：本周费城半导体指数涨跌幅为+7.26%



资料来源：iFinD，爱建证券研究所

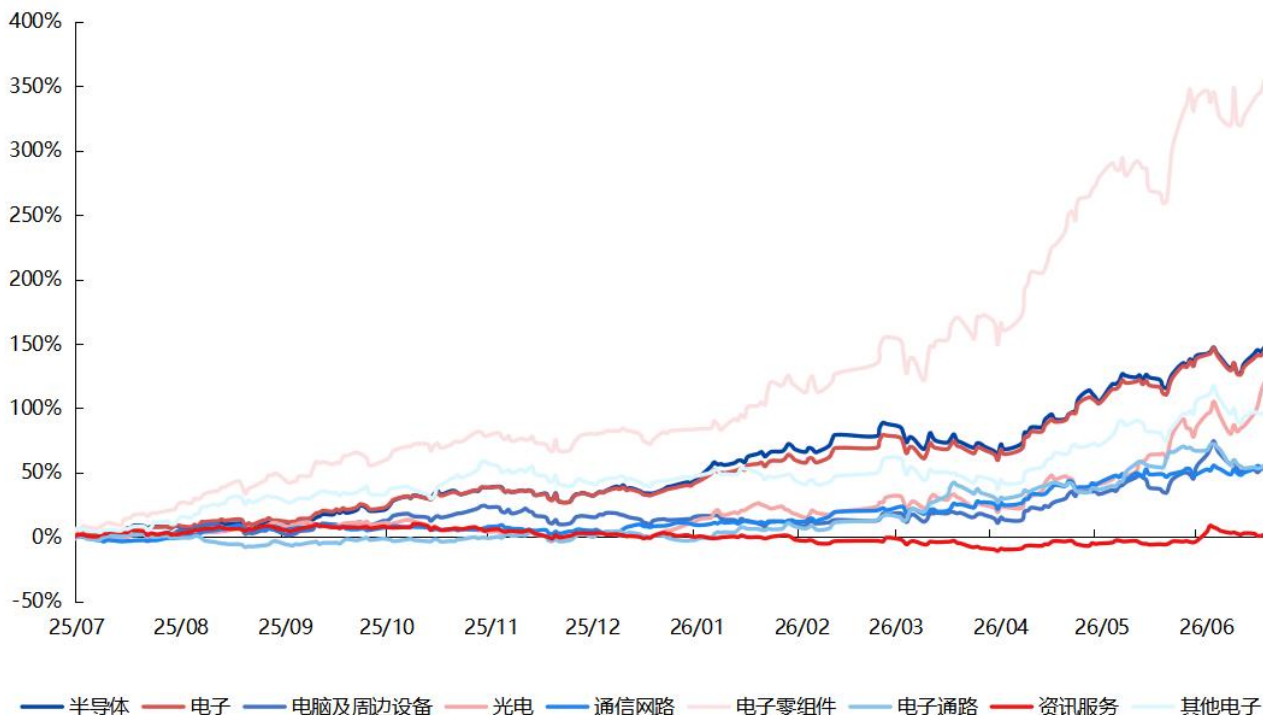
图表 6：本周恒生科技指数涨跌幅为-2.14%



资料来源：iFinD，爱建证券研究所

中国台湾电子指数各细分板块本周涨跌幅分别为：光电（+17.95%）、电子零组件（+6.55%）、半导体（+5.35%）、电子（+5.10%）、通信网路（+1.90%）、其他电子（+1.55%）、电子通路（+1.35%）、电脑及周边设备（+0.99%）、资讯服务（-1.27%）。

图表 7：2025 年 6 月-2026 年 6 月中国台湾电子指数涨跌幅一览



资料来源：iFinD，爱建证券研究所

2. 全球产业动态

2.1 SK Hynix 开始供应 HBM4E

新闻：2026 年 6 月 18 日，SK Hynix 宣布已向主要客户供应 12 层 HBM4E 样品，该产品是面向人工智能（AI）的下一代超高性能 DRAM。

相较于 HBM4，HBM4E 实现性能与能效大幅提升，最高引脚速率 16Gbps，能效优化超过 20%，可有效增强 AI 训练、推理的数据处理能力。产品通过全新接口与结构设计降低传输延迟，高带宽负载下运行稳定，有望显著提升新一代 AI 数据中心、大型计算系统的整体运算效率。

依托 HBM3/HBM3E/HBM4 系列成熟量产交付经验，SK Hynix 将持续联合客户推进 HBM4E 产品迭代落地，解决 AI 算力系统现存性能瓶颈，助力全球新一代算力基础设施建设。

爱建观点：SK Hynix 推出新一代 12 层 HBM4E 并向客户送样，产品性能、能效相较 HBM4 大幅优化，叠加公司成熟 HBM 量产交付能力，将持续推高 HBM 及上下游产业链景气度，AI 内存增量市场空间广阔。

2.2 TSMC 与 Amkor 达成为期 10 年合作协议

新闻：2026 年 6 月 16 日，TSMC（台积电）与 Amkor Technology（安靠）共同

宣布：双方达成了一项为期 10 年的协议，以促进强有力的合作伙伴关系，增强美国亚利桑那州先进的半导体封装能力，加强并加快对美国半导体供应链生态系统的投资。

本次协议搭建长期采购框架，TSMC 将向 Amkor 采购一站式先进封装与芯片测试服务，配套凤凰城晶圆厂产出的先进制程芯片。双方厂区地理位置邻近，前端制造与后端封测就近协同，能够缩短芯片交付周期，打造稳定性更强的本土一体化供应链。

Amkor 在亚利桑那皮奥里亚规划总投资 70 亿美元先进封装园区，项目分两期建设，建成后洁净车间总面积 75 万平方英尺，可提供 3000 个本地就业岗位；园区一期 2027 年年中完工、2028 年初投产，主营 InFO、CoWoS 等高端封装工艺，适配 AI 与高性能计算芯片需求。

Amkor 为美国规模最大的独立封测服务商，同时扩建韩国光州工厂承接 TSMC 全球先进封装订单；TSMC 也计划 2029 年前在亚利桑那自建 CoWoS、3D IC 产线，与 Amkor 产能形成配套互补。

爱建观点：TSMC 与 Amkor 十年长约落地，有效填补美国本土高端先进封测产能缺口，加速海外 AI 算力芯片本地化制造布局，全球先进封装赛道长期需求具备支撑。

2.3 索尔思光电拟 12 亿美元扩产 AI 光芯片、高速光模块

新闻：2026 年 6 月 16 日东山精密公告，全资子公司索尔思光电拟自筹 12 亿美元扩建常州光芯片、光模块产能，现有产能无法覆盖 AI 算力长期订单，扩产将扩充高端光互联产能、强化垂直一体化布局。

盈利层面，索尔思 2025 年营收、利润分别占上市公司 3.58%、22.69%，2026Q1 营收占比攀升至 16.02%、利润贡献达 52.92%，光通信已成公司核心盈利板块，经营稳健。

技术端公司具备光芯片自研、晶圆制造、封测、光模块组装全链条能力，高端 EML 光芯片实现量产，高速光模块批量供应海外头部云厂商与 AI 硬件企业，技术储备为本次扩产提供支撑。

爱建观点：AI 算力带动 800G、1.6T 光互联需求持续高增，本次大额扩产匹配下游中长期订单增量。依托索尔思光芯片到光模块一体化优势，新基地投产后高端产品产能持续释放，缓解行业芯片供给紧缺；光通信已是公司核心利润板块，产能落地有望抬升板块盈利中枢，业绩增长确定性提升。

2.4 Samsung 首获 Neuralink 芯片制造代工

新闻：据 2026 年 6 月 15 日韩国经济日报报道，Samsung 晶圆代工拿下 Neuralink 四代脑机芯片订单，系公司首次承接植入式脑机芯片量产业务。芯片采用 Samsung 4nm 工艺，项目 2025 年末启动研发，2026 年 5 月投片试产，样品将于 2027H1 交

付，2027 年底量产落地。

Neuralink 前三代芯片均由 TSMC 代工，引入 Samsung 实现供应链多元化布局；第四代芯片支持脑机双向信号传输，应用于神经疾病康复医疗试验。

爱建观点：Samsung 斩获 Neuralink 脑机芯片代工订单，代工品类自车载 AI 延伸至医疗特种芯片，4nm 工艺匹配植入芯片高可靠性要求。头部客户双供格局显现，脑机接口产业化进程加快，Samsung 高端制程订单结构有望改善。

3. 风险提示

1) 海外存储大厂技术迭代、产能释放超预期：SK Hynix HBM4E 已完成客户送样，若后续快速实现大规模量产、大幅放开高端 HBM 产能供给，会加剧全球 HBM 市场供给竞争，压缩国内存储厂商 HBM 产品的价格与盈利空间，延缓国产存储份额提升节奏。

2) 国产存储技术研发与量产进度不及预期：当前 SK Hynix 海外厂商已完成新一代 HBM 样品验证并推进迭代，若国内厂商在 12 层及以上堆叠 HBM、高速接口等核心技术研发落地、良率爬坡进度滞后，将持续拉大与海外龙头产品代差，难以充分承接 AI 内存增量市场红利。

爱建证券有限责任公司

上海市浦东新区前滩大道 199 弄 5 号

电话: 021-32229888

传真: 021-68728700

服务热线: 956021

邮政编码: 200124

邮箱: ajzq@ajzq.com

网址: <http://www.ajzq.com>

评级说明

投资建议的评级标准

报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即以报告发布日后的 6 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场：沪深 300 指数（000300.SH）；新三板市场：三板成指（899001.CSI）（针对协议转让标的）或三板做市指数（899002.CSI）（针对做市转让标的）；北交所市场：北证 50 指数（899050.BJ）；香港市场：恒生指数（HIS.HI）；美国市场：标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）。

股票评级

买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 15%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5% ~ 15% 之间
持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 -5% ~ 5% 之间
卖出	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于 -5%

行业评级

强于大市	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
弱于大市	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告采用信息和数据来自公开、合规渠道，所表述的观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的独立看法。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法可能存在局限性，请谨慎参考。

法律主体声明

本报告由爱建证券有限责任公司（以下统称为“爱建证券”）证券研究所制作，爱建证券具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管。

本报告是机密的，仅供我们的签约客户使用，爱建证券不因收件人收到本报告而视其为爱建证券的签约客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但爱建证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供签约客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，爱建证券及其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测后续可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，爱建证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

版权声明

本报告版权归爱建证券所有，未经爱建证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用。否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。版权所有，违者必究。